

6月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要..... 4

一、 宏观动态..... 5

 (一) 行业政策..... 5

 (二) 经济指数..... 7

二、 半导体产业动态..... 11

 (一) 短期影响..... 12

 (二) 中期影响..... 12

 (三) 长期影响..... 13

三、 终端市场动态..... 15

 (一) 人工智能..... 16

 (二) 新能源..... 16

 (三) 消费电子..... 16

 (四) 工业电子..... 17

 (五) 汽车电子..... 17

 (六) 通信电子..... 17

 (七) 医疗电子..... 18

四、 重点产品行情..... 19

 (一) 存储芯片..... 19

 (二) GPU..... 20

 (三) MCU..... 21

信息来源..... 23

免责声明..... 26

摘要

2025 年 6 月重点行情趋势	
宏观动态	● WSTS 预测：2025 年全球半导体市场规模可达 7009 亿美元，增长 11.2% ● 欧盟《芯片法案》进展，2030 年市场份额目标仍难实现 ● 日本 50 万亿日元押注芯片自给，台积电扩建延迟成变数 ● 韩国新政府计划增加半导体支出，并推动 AI 驱动增长 ● 格芯承诺投入 160 亿美元，加强美国半导体制造
产业动态	● 美光 DDR4 断供引发存储市场震荡，长鑫存储加速替代 ● 英飞凌车规 MCU 扩产难解工业芯片短缺，交货周期仍达 40 周 ● 英伟达 AI 超算争夺 CoWoS 产能，非 AI 芯片交付延迟 3-6 个月 ● 三星玻璃基板封装突破台积电垄断，HBM4 良率爬坡承压 ● 德州仪器/亚德诺联合推出 10W 边缘 AI 协处理器，支持 100TOPS 算力 ● 恩智浦整合 TTTech Auto 重构软件定义汽车生态 ● 台积电亚利桑那州厂量产 4nm 芯片，CoWoS 产能向 AI 倾斜 ● 博通发布 Tomahawk 6 交换机，单芯片带宽 102.4Tbps ● 瑞萨解散 SiC 团队转向 GaN，收购 Transphorm 整合技术 ● 中芯国际 28nm 产能利用率 95%承接汽车订单，Q1 营收逆势增 1.8%
终端市场	● 人工智能：英伟达计划在欧洲建设 20 家 AI 工厂，目标两年内将欧洲 AI 算力提升 10 倍；百度启动最大规模 AI 人才招聘，岗位扩增超 60%覆盖 23 个业务领域 ● 新能源：宁德时代子公司与中国一汽等在香港签署协议，宣布推进香港换电网络建设；比亚迪官宣欧洲总部落户匈牙利，中国车企全球化布局提速 ● 消费电子：荣耀手机海外预售量超预期 2-3 倍，400 系列在欧洲、东南亚需求强劲；埃斯顿酷卓发布第二代人形机器人 Codroid 02，解锁工业应用新可能 ● 工业电子：海能达推出“专网通信+机器狗”解决方案 ● 汽车电子：奔驰将在亚特兰大设北美总部，并转移 500 个岗位投建研发设施 ● 通信电子：中兴通讯与广西大数据发展局签署战略合作协议 ● 医疗电子：西门子医疗拟收购 Sirtex Medical 加码癌症靶向治疗领域
产品行情	● 存储芯片：NAND 闪存产能收缩超 30%，DDR4 内存因停产通知引发囤货潮 ● GPU：英伟达占据 AIB 市场 92%份额，英特尔市场份额则跌至 0% ● MCU：MCU 车规市场规模可观，国产替代化加速

一、宏观动态

(一) 行业政策

● WSTS 预测：2025 年全球半导体市场规模可达 7009 亿美元，增长 11.2%

世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 6 月 3 日发布的《2025 年春季半导体市场预测》显示，全球半导体市场正强劲复苏并持续扩张。预计 2025 年市场规模将达 7009 亿美元，同比增长 11.2%，延续 2024 年反弹态势；2026 年将再增长 8.5%，规模增至约 7607 亿美元。逻辑芯片与存储器两大细分市场，受 AI、云计算及先进消费电子需求驱动，成为增长主因。从区域看，美洲和亚太地区增长势头突出，2025 年预计分别增长 18.0%和 9.8%。

Spring 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	230,256	252,472	45.2	18.0	9.6
Europe	51,250	52,969	56,201	-8.1	3.4	6.1
Japan	46,739	47,037	49,776	0.0	0.6	5.8
Asia Pacific	337,437	370,613	402,252	16.4	9.8	8.5
Total World - \$M	630,549	700,874	760,700	19.7	11.2	8.5
Discrete Semiconductors	31,026	30,219	32,733	-12.7	-2.6	8.3
Optoelectronics	41,095	39,290	39,956	-4.8	-4.4	1.7
Sensors	18,923	19,782	20,622	-4.1	4.5	4.2
Integrated Circuits	539,505	611,582	667,390	25.9	13.4	9.1
Analog	79,588	81,642	85,535	-2.0	2.6	4.8
Micro	78,633	77,840	80,186	3.0	-1.0	3.0
Logic	215,768	267,259	286,842	20.8	23.9	7.3
Memory	165,516	184,841	214,826	79.3	11.7	16.2
Total Products - \$M	630,549	700,874	760,700	19.7	11.2	8.5

数据来源: World Semiconductor Trade Statistics

● 欧盟《芯片法案》进展，2030 年市场份额目标仍难实现

欧盟实施的《芯片法案》已将超 85% 预算用于试点生产线建设及成员国能力中心设立，撬动超 800 亿欧元制造业投资，并获批七项“首创型”国家援助。然而欧洲审计院评估显示，欧盟 2030 年全球半导体市场份额目标（20%）恐难实现，预计仅达 11.7%。为此“芯片法案 2.0”讨论升温，拟聚焦 AI 芯片设计、高能效架构、光子学及量子半导体等新领域，同时平衡成员国发展。这与 WSTS 预测形成反差——该机构预计 2025 年欧洲半导体市场仅温和增长。

● 日本 50 万亿日元押注芯片自给，台积电扩建延迟成变数

日本正在积极推行其“经济安全时刻”战略，目标是在未来十年内注入高达 50 万亿日元（约合 3470 亿美元）的公共和私人投资，以增强其国内微芯片生产能力。其关键举措包括政府对下一代

芯片和量子计算研究的资助，以及通过 Rapidus 公司支持国内先进芯片生产，该公司计划到 2027 年实现尖端芯片的量产。然而，《日本时报》报道称，作为关键合作伙伴的台积电（TSMC）表示其在熊本县的第二座工厂扩建可能出现延迟，这给日本的计划带来了挑战。

- **韩国新政府计划增加半导体支出，并推动 AI 驱动增长**

6 月 3 日李在明胜选韩国总统后，韩国新政府正在筹备新产业战略，拟增加半导体、清洁能源及数字基础设施的公共支出，以发展韩国 AI 产业，深化全球数据监管、国防和研发合作。当下全球高带宽存储器（HBM）需求旺盛，SK 海力士等企业业绩亮眼。为应对全球竞争，韩国企业加速研发并布局下一代产品。李在明在 6 月 17 日 G7 峰会上聚焦全球能源安全与 AI 合作，契合 WSTS 预测，即 2025 - 2026 年存储器，特别是 AI 用 HBM 将成增长先锋。

- **格芯承诺投入 160 亿美元，加强美国半导体制造**

6 月 4 日，格芯（Global Foundries）宣布，计划投资 160 亿美元扩建美国本土半导体制造能力，旨在通过供应链本土化应对 AI 领域“爆炸性增长”，获得特朗普政府及苹果、SpaceX 等科技巨头支持。资金将用于纽约州与佛蒙特州工厂扩建，聚焦先进封装、硅光子学及下一代氮化镓（GaN）技术研发，以强化美国半导体领导地位，加速 AI、航空航天、汽车及高性能通信领域创新。此举与 WSTS 预测呼应，该机构预计 2025 年美洲半导体市场将以 18.0% 的增速领跑，为 AI 驱动技术与高性能计算的产能需求提供支撑。

(二) 经济指数

● 2025 年 5 月全球制造业 PMI 分析：全球制造业持续疲软，区域走势分化；人工智能及存储器价格持续上涨提振半导体需求

2025 年 5 月全球制造业 PMI 为 49.6，连续第二个月出现小幅萎缩。这种普遍的疲软态势预示着整体终端产品需求环境趋于谨慎，这可能会抑制通用半导体元件的订单增长。此外，关税带来的持续干扰继续加剧全球经济复苏的不确定性，影响包括制造业在内的各个行业。近期，经济合作与发展组织（OECD）下调了 2025 年世界经济增长预测，联合国也预计今年全球经济增长将放缓。

区域数据分化明显：中、日、韩等亚洲制造业中心 PMI 均低于 50，消费电子、汽车等领域半导体内需疲软，而印度 PMI 达 57.6 保持强劲扩张，彰显电子设备需求潜力与半导体投资机遇；欧美市场方面，美洲 PMI 持续收缩至 48.5，欧元区改善至 49.5 显示制造业低迷有所缓解。

尽管制造业整体疲软，半导体行业却呈现不同态势：Trend Force 数据显示，2025 年 5 月 DDR3/DDR4 价格持续上涨，AI 驱动的高性能存储需求消耗全球产能，导致常规 DRAM 供应紧张，凸显细分市场需求与关键元器件供应限制对半导体市场的结构性影响。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	美国	欧元区
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	49.10	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	47.80	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	50.30	46.10
2024-04	50.30	50.40	49.60	49.40	58.80	49.20	45.70
2024-05	50.90	49.50	50.40	51.60	57.50	48.70	47.30
2024-06	49.50	49.50	50.00	52.00	58.30	51.70	45.60
2024-07	49.80	49.40	49.10	51.40	58.10	46.80	45.80
2024-08	48.90	49.10	49.80	51.90	57.50	47.20	45.60
2024-09	48.80	49.80	49.70	48.30	56.50	47.20	45.00
2024-10	48.80	50.10	49.80	48.30	57.50	46.50	46.00
2024-11	50.00	50.30	49.00	50.60	56.50	48.40	45.20
2024-12	49.60	50.10	49.60	49.00	56.40	49.20	45.10
2025-1	50.10	49.10	48.70	50.30	57.70	50.90	46.60
2025-2	50.60	50.20	49.00	49.90	56.30	50.30	47.60
2025-3	50.30	50.50	48.40	49.10	58.10	49.00	48.60
2025-4	49.80	49.00	48.70	47.50	58.20	48.70	49.00
2025-5	49.60	49.50	49.40	47.70	57.60	48.50	49.50

数据来源：Wind

● 全球半导体市场保持增长态势，4 月全球半导体销售额实现环比增长 2.5%

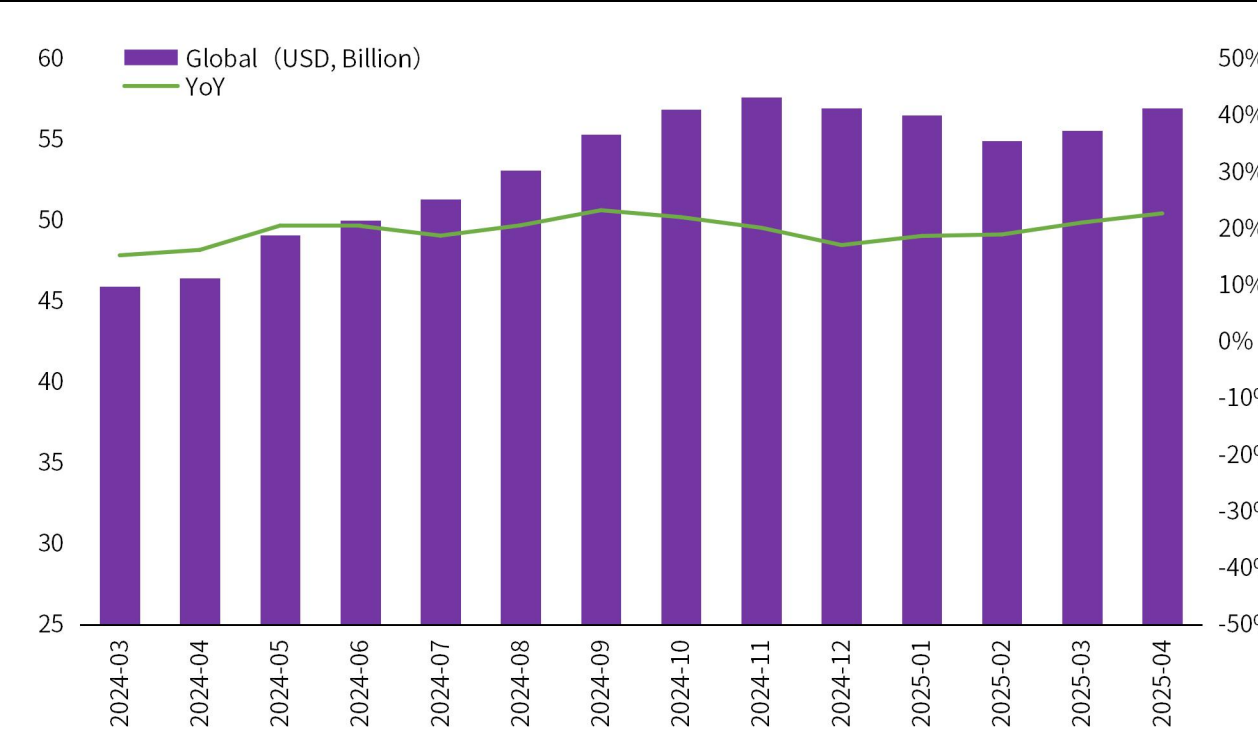
2025 年 4 月全球半导体销售额达到 570 亿美元。这标志着较 2025 年 3 月的 556 亿美元实现了显著的 2.5%环比增长。此次月度销售额的上升是 2025 年以来的首次环比增长，并且在 2024 年 4 月 464 亿美元的基础上，实现了高达 22.7%的强劲同比增长。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 就市场表现发表评论指出：“2025 年 4 月全球半导体销售额首次实现环比增长，并且在全球市场中，在美洲和亚太地区销售增长的推动下，持续录得同比增长。”

通过对区域表现的分析，4 月各主要市场的销售额均呈现显著的同比增长：美洲地区以 44.4% 的增幅居首，其次是亚太/其他地区增长 23.1%，中国增长 14.4%，日本增长 4.3%，而欧洲也实现了 0.1%的增长。从环比来看，4 月销售额在中国 (5.5%)、亚太/其他地区 (5.3%) 和欧洲 (0.5%) 均有所增长。与此相反，日本销售额略微下降 0.6%，而美洲地区则较 3 月下降了 1.1%。

世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 在《2025 年春季全球半导体销售预测》中预计，2025 年全球年度销售额将强劲增长 11.2%，达到 7009 亿美元。展望更远的未来，预计 2026 年全球销售额将进一步攀升至 7607 亿美元。

全球半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

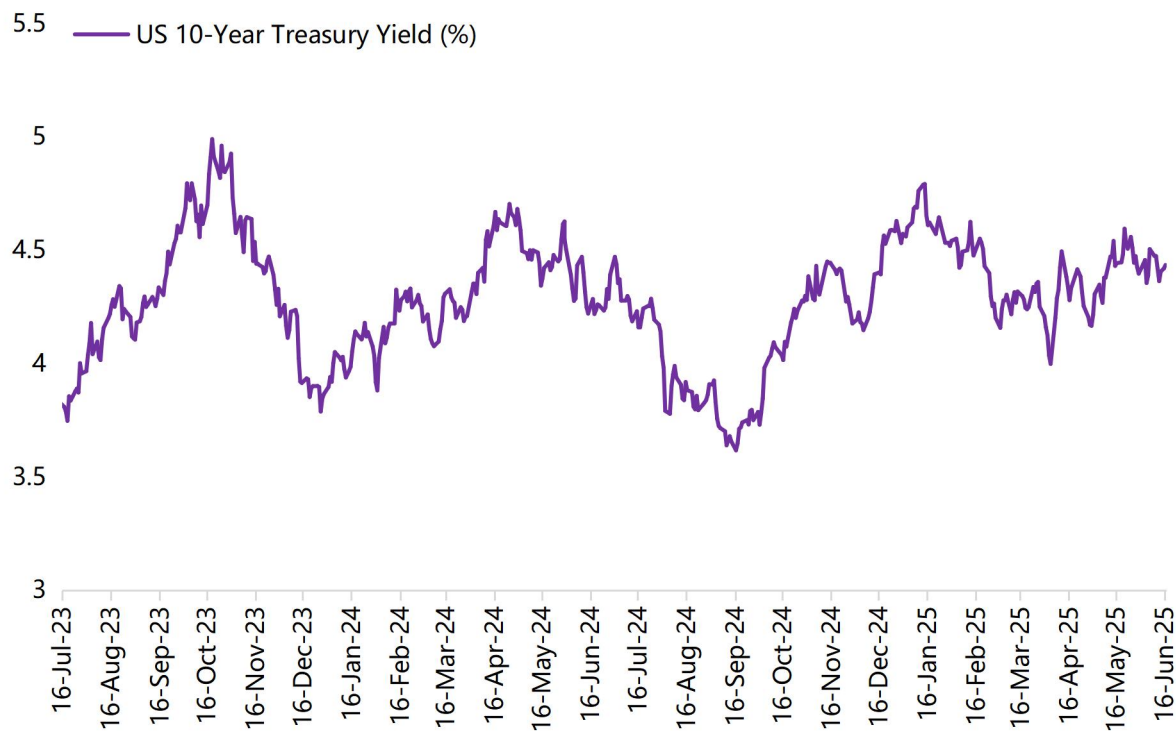
● 美国 10 年期国债收益率呈下行趋势，利率预期演变

2025 年 6 月，美国 10 年期国债收益率呈现出明显的下行趋势，从月初的约 4.4%-4.5%降至 6 月中旬的约 4.3%。此番下降发生于 2025 年 5 月收益率徘徊在 4.481%左右之后。6 月的这次下跌表明市场对美联储（Federal Reserve）潜在降息的预期再度升温，这很可能受到新的经济数据影响，这些数据可能预示着通胀降温或经济增长的轻微放缓。收益率的这种下降通常反映出投资者寻求政府债券的相对安全性，这可能是出于对全球经济不确定性或对鹰派货币政策预期重新评估的考虑。

对于半导体行业而言，10 年期国债收益率的这种下行趋势，与前期利率上升时期相比，提供了一个更为有利的金融环境。通常，较低的收益率意味着企业借贷成本的降低，使得大规模资本支出，例如对新建晶圆厂和先进研发的投资，在经济上更具吸引力。

这种环境为半导体公司至关重要的产能扩张和技术领先地位提供长期战略投资的有利条件。尽管 5 月报告中强调的地缘政治紧张局势和关税不确定性仍是需要持续关注的因素，但借贷成本持续走低趋势能显著增强半导体公司的财务韧性和增长潜力，从而积极影响投资决策和整体市场情绪。

美国 10 年期国债利率(%)



数据来源：Investing

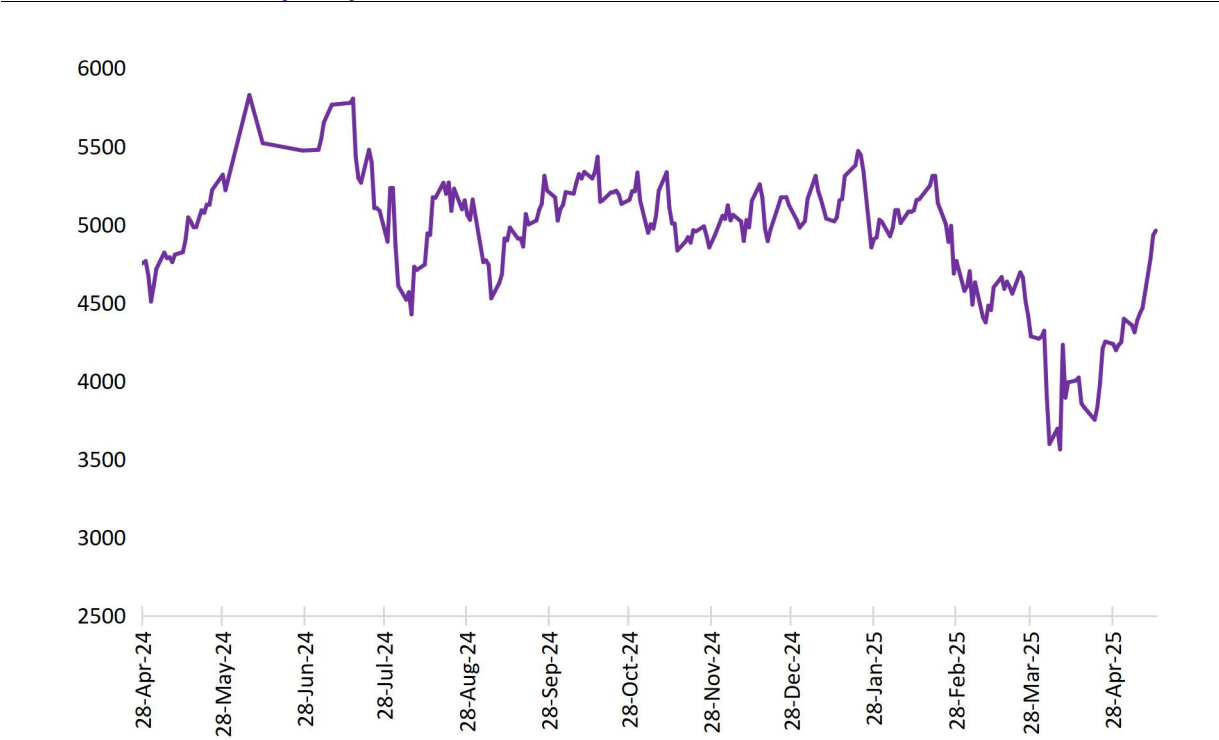
● 费城联储调查报告：强劲增长，预示 6 月投资者信心强劲

费城半导体指数（SOX）在 2025 年 5 月表现出卓越的强势，并持续到 6 月中旬，这显著增强了投资者的信心。这种强劲的表现凸显了市场对半导体行业的看涨情绪，其驱动力来自于强劲的需求，特别是高性能计算和人工智能（AI）领域的贡献。

2025 年 5 月为这一势头奠定了坚实基础。在 4 月平均值约为 3,993.90 点之后，SOX 指数在 5 月初以 4,397.05 点开盘，尽管月内有所波动，但最终收于 4,790.06 点，月平均值为 4,690.77 点。这标志着较 4 月平均值大幅上涨 17.44%，表明市场兴趣重新强劲。5 月所展现出的韧性，即便在全球制造业指标喜忧参半的情况下，也凸显了市场日益关注半导体行业强大的需求驱动力。

这种积极势头在 2025 年 6 月强劲延续并加速。SOX 指数在 6 月 3 日以 4,964.41 点开盘后，果断走高，持续在 5,000 点上方交易。到 6 月 12 日，它达到了 5,249.15 点的显著高点。截至 6 月 12 日，SOX 指数的平均值已达到 5,085.26 点。这一平均值较 5 月平均值增长了惊人的 8.41%，预示着持续且不断增强的看涨投资者情绪。

费城半导体指数(SOX)



数据来源：MacroMicro

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	美光 Micron	DDR4 断供引发存储市场震荡，长鑫存储加速替代	美光退出 DDR4 导致报价跳涨 50%，长鑫 19nm 良率 85% 抢占 30% 份额，短期缓解 PC/服务器供应链压力
	英飞凌 Infineon	车规 MCU 扩产难解工业芯片短缺，交货周期仍达 40 周	马来西亚厂产能提升 20% 缓解车用芯片缺口，但工业 IGBT 供需失衡凸显成熟制程分配矛盾
	英伟达 NVIDIA	AI 超算争夺 CoWoS 产能，非 AI 芯片交付延迟 3-6 个月	2nm GB300 芯片优先分配台积电 CoWoS 资源，AMD/英特尔等客户面临产能挤压
中期影响	三星 Samsung	玻璃基板封装突破台积电垄断，HBM4 良率爬坡承压	2028 年商用技术提升芯片速度 40%，但 5nm 光刻精度要求致 HBM4 量产良率仅 65%
	德州仪器/亚德诺 TI/ADI	联合推出 10W 边缘 AI 协处理器，支持 100TOPS 算力	竞逐工业无人化场景，直面寒武纪 MLU370-X8 (128TOPS@15W) 低延迟挑战
	恩智浦 NXP	整合 TTTech Auto 重构软件定义汽车生态	舱驾融合方案缩短车企开发周期 40%，迎战高通-奔驰联盟
长期影响	台积电 TSMC	亚利桑那州厂量产 4nm 芯片，CoWoS 产能向 AI 倾斜	美国本土化生产仍依赖台湾封装，催化中国大陆发展 XDFOI 自主技术
	博通 Broadcom	发布 Tomahawk 6 交换机，单芯片带宽 102.4Tbps	CPO 光互联降低超算中心功耗 25%，重构 AI 网络架构
	瑞萨 Renesas	解散 SiC 团队转向 GaN，收购 Transphorm 整合技术	SiC 价格战致营收下滑 9%，GaN 授权生产模式降本 28%
	中芯国际 SMIC	28nm 产能利用率 95% 承接汽车订单，Q1 营收逆势增 1.8%	成熟制程优势应对关税风险，市占率 6% 挑战三星

（一）短期影响

- **美光 DDR4 断供引发存储市场震荡，长鑫存储加速替代**

美光突然终止 DDR4 供应引发存储市场结构性震荡，导致消费级 DDR4 价格单月飙升近 50%，迫使终端厂商紧急转向长鑫存储（19nm 良率 85%）或提前导入 DDR5 方案。此事件暴露成熟制程供应链的脆弱性，同时加速长鑫在中国国内市场份额突破 30%。值得注意的是，美光保留车规级 DDR4 供应的策略催生“消费电子替代加速、工控领域维稳”的分化格局，长期将倒逼中国加速 28nm DDR4 自主产线建设以重构产业链韧性。

- **英飞凌车规 MCU 扩产难解工业芯片短缺，交货周期仍达 40 周**

英飞凌马来西亚工厂车规 MCU 扩产 20%仅局部缓解电动车芯片短缺，而工业级 IGBT 交期仍维持 40 周以上，凸显成熟制程产能分配的结构性矛盾——车规芯片扩产挤占工业资源。中期需重构产能配置模型，长期则驱动 IDM 企业向区域化制造转型，通过地理分散提升全链条抗风险能力。

- **英伟达 AI 超算争夺 CoWoS 产能，非 AI 芯片交付延迟 3-6 个月**

英伟达于 6 月绑定台积电 2nm GB300 超算项目独占 CoWoS 封装产能，直接导致 AMD 等非 AI 芯片交期延后 3-6 个月，进一步巩固其在 AI 训练市场的统治地位。此合作强化“欧美设计-台湾制造”技术联盟，压缩中国大陆获取先进制程的空间，长期可能催化中国自主封装技术（如 XDFOI）发展，但地缘风险加剧全球技术体系割裂。

（二）中期影响

- **三星玻璃基板封装突破台积电垄断，HBM4 良率爬坡承压**

三星玻璃基板封装技术计划 2028 年商用，理论性能提升 40%/功耗降 30%，意图打破台积电 CoWoS 垄断，但其 HBM4 因 16 层堆叠与 5nm 光刻精度限制面临良率仅 65%的爬坡困境。该技术突破若成功，将与投资 Rainbow Robotics 构建的“AI 芯片-人形机器人”生态闭环形成协同，抢占具身智能终端战略高地。

- **德州仪器/亚德诺联合推出 10W 边缘 AI 协处理器，支持 100TOPS 算力**

TI/ADI 于 6 月联合推出 10W TDP 的 100TOPS 边缘 AI 协处理器，通过集成多传感器降低工业场景部署成本 30%，但中期遭遇寒武纪 MLU370-X8(128TOPS@0.75ms

延迟)在低时延场景的强势竞争,需在实测中将响应压至 0.8ms 以下并应对国产芯片 40%价格优势。其长期竞争力依赖制程向 3nm 迭代,否则存算一体架构可能颠覆现有能效模型。

- **恩智浦整合 TTTech Auto 重构软件定义汽车生态**

恩智浦整合 TTTech Auto 的 MotionWise 中间件后,实现硬件-软件深度耦合的舱驾一体方案,缩短车企开发周期 40% (如宝马平台交付从 24 月降至 14 月)。中期通过开放 S32G/V2X 接口支持多芯片厂商降低 30%集成成本,但长期向中央计算架构演进时需直面高通-奔驰"One Brain"联盟(已获 12 家车企支持)的生态围剿。

(三) 长期影响

- **台积电亚利桑那州厂量产 4nm 芯片, CoWoS 产能向 AI 倾斜**

台积电亚利桑那州厂 4nm 量产暴露美国产业链短板——晶圆仍需返台封装,中期与 Amkor 合建封装厂(2026 投产)以缓释地缘风险。其 CoWoS 产能持续向 AI 芯片倾斜的策略,将加速中国大陆 XDFOI 等自主封装技术的突围进程,重塑全球先进制程竞争格局。

- **博通发布 Tomahawk 6 交换机, 单芯片带宽 102.4Tbps**

博通发布全球首款单芯片带宽 102.4Tbps 的 Tomahawk 6 交换机,短期通过 CPO (共封装光学)技术实现光-电协同,满足百万级 XPU 集群的极限互联需求(如 Meta 300,000 卡集群时延降至 1.2μs);中期搭载认知路由 2.0 引擎,通过强化学习动态优化 AI 任务传输路径,提升分布式训练效率 40% (ResNet-502 训练时间从 18 天缩至 11 天);长期主导 Ultra Ethernet Consortium (UEC) 标准制定,推动以太网从"尽力而为"向"确定性低延迟"范式转型,颠覆 InfiniBand 在超算中心的主导地位(预计 2027 年渗透率超 35%)

- **瑞萨解散 SiC 团队转向 GaN, 收购 Transphorm 整合技术**

面对 SiC 市场价格战加剧与主要供应商 Wolfspeed 潜在破产风险,瑞萨近期解散其 SiC 团队并出售高崎工厂设备,标志其短期内全面退出 SiC 赛道。随着 SiC 衬底价格暴跌至 400 美元、逼近成本线,瑞萨在 2025 年第一季度相关营收下滑达 9%。在中期策略上,公司转向 GaN (氮化镓)授权生产模式,通过外包 Polar Semiconductor 进

行代工以实现降本 28%。长期来看，瑞萨加速整合收购的 Transphorm 核心技术，布局高效 GaN 解决方案，瞄准数据中心、电动汽车与航天等高增长场景，力图在第三代半导体的下一轮竞争中突围。

- **中芯国际 28nm 产能利用率 95%承接汽车订单，Q1 营收逆势增 1.8%**

中芯国际第一季度营收达 22.47 亿美元，同比增长客四环比上升 1.8%，实现逆势增长。其 28nm 制程产能利用率高达 95%，主要用于承接汽车电子订单，彰显成熟制程在当前市场中的关键支撑作用。中期来看，公司通过加强本土备货策略，有效应对对美关税不确定性，并维持近 6% 的市场份额，稳健挑战三星在晶圆代工领域的第二席位。长期则面临先进制程瓶颈亟待突破，以进一步扩大份额并提升全球竞争力。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
类别	版块	厂商	4-5 月市场动态
人工智能	AI 芯片	英伟达 NVIDIA	计划在欧洲建设 20 家 AI 工厂，目标两年内将欧洲 AI 算力提升 10 倍
	云计算与大数据	百度 Baidu	启动最大规模 AI 人才招聘，岗位扩增超 60%，覆盖 23 个业务领域
新能源	光伏、储能	宁德时代 CATL	子公司与中国一汽等在香港签署协议，宣布推进香港换电网络建设
	新能源汽车	比亚迪 BYD	官宣欧洲总部落户匈牙利，中国车企全球化布局提速
消费电子	智能手机	荣耀 HONOR	海外预售量超预期 2-3 倍，400 系列在欧洲、东南亚需求强劲
	机器人	埃斯顿酷卓 Estun Codroid	发布第二代人形机器人 Codroid 02，解锁工业应用新可能
工业电子	工业自动化与控制	海能达 Hytera	推出“专网通信+机器狗”解决方案
汽车电子	汽车产业链	奔驰 Mercedes-Benz	将在亚特兰大设立北美总部，并转移 500 个岗位投建研发设施
通信电子	通信网络、光纤	中兴通讯 ZTE	与广西大数据发展局签署战略合作协议
医疗电子	医疗影像设备	西门子医疗 Siemens Healthineers	拟收购 Sirtex Medical 加码癌症靶向治疗领域

（一）人工智能

- **英伟达计划在欧洲建设 20 家 AI 工厂，目标两年内将欧洲 AI 算力提升 10 倍**

6 月 11 日，英伟达 CEO 黄仁勋在 GTC 巴黎大会上发表主题演讲，宣布英伟达正在 7 个欧洲国家建立专注于研究的 AI 技术中心，并计划在欧洲建造超 20 座用于训练和支持 AI 模型的大型 AI 工厂，目标是在 2026 年前让欧洲的 AI 算力提升 10 倍，最终在该地区内建立完整的 AI 生态系统。

- **百度启动最大规模 AI 人才招聘，岗位扩增超 60%，覆盖 23 个业务领域**

6 月 14 日，百度举办 AIDU 计划-Deep Talk 开放日活动，并宣布 2026 届“AIDU 计划”启动，这也是百度最大规模的顶尖 AI 人才招聘。相比去年，今年 AIDU 计划的岗位招聘扩增了超 60%，覆盖百度 23 个核心业务和 11 类研究方向，主要聚焦大模型算法、大模型基础架构、机器学习、语音技术、智能体等人工智能最前沿领域。

（二）新能源

- **宁德时代子公司与中国一汽等在香港签署协议，宣布推进香港换电网络建设**

6 月 13 日，宁德时代子公司时代电服、时代小桔新能源与中国第一汽车集团、龙昇新能源在香港签署战略合作协议，宣布共同推进换电式营运车辆在香港规模化应用，同步启动香港换电基础设施建设。中国一汽负责车型开发与售后保障，时代电服负责电池资产运营及回收利用，时代小桔提供换电站数字化运营支持，龙昇新能源落地本地基建与车辆推广。合作规划到 2026 年底前建成 10 站，形成覆盖香港各区的换电网络。

- **比亚迪官宣欧洲总部落户匈牙利，中国车企全球化布局提速**

5 月 15 日，比亚迪在匈牙利布达佩斯第 11 区设立欧洲总部，标志着其欧洲市场战略布局进入新阶段。该总部将承载销售与售后、车辆认证及测试、车型本地化设计与功能开发等职能，还计划未来三年在匈牙利投资超 5 亿欧元建设研发中心和区域物流枢纽，并创造约 2000 个就业岗位。

（三）消费电子

- **荣耀手机海外预售量超预期 2-3 倍，400 系列在欧洲、东南亚需求强劲**

5 月 29 日，据荣耀官方透露，荣耀 400 系列手机预售量较品牌预期高出 2-3 倍，

其中欧洲市场因当地消费电子需求复苏及产品本地化适配策略，东南亚市场则依托人口红利与新兴消费趋势，均呈现较强劲的市场反馈。

- **埃斯顿酷卓发布第二代人形机器人 Codroid 02，解锁工业应用新可能**

6月11日，在2025智能机器人发展大会上，由国产工控巨头埃斯顿创立的机器人制造企业——埃斯顿酷卓发布了第二代人形机器人 Codroid 02，该机器人采用一体化关节模组，可实现力量与精度动态平衡，核心部件全自研。Codroid 02 通过视频展示了在工业场景的应用能力，可完成部件抓取、物料搬运等体力工作，也能实现螺丝锁付、质检巡检等精细化操作，还具备在线学习能力，能拓展技能库以适应柔性制造需求。

(四) 工业电子

- **海能达推出“专网通信+机器狗”解决方案**

6月9日，海能达宣布将自研宽带自组网技术与机器狗融合，推出“专网通信+机器狗”解决方案。该方案可应用于日常巡检、警用巡逻、大型安保、应急救援等场景，未来指挥人员能通过调度终端或对讲机，对无人机、机器狗等无人化智能设备下达指令。目前机器狗技术持续迭代，海能达也将推动方案升级，结合 AI 专网技术，推出更多相关应用及解决方案。

(五) 汽车电子

- **奔驰将在亚特兰大设立北美总部，并转移 500 个岗位投建研发设施**

5月22日，梅赛德斯-奔驰宣布，将通过集中和整合公司关键职能部门，在亚特兰大建立梅赛德斯-奔驰的北美总部。同时，该公司将向美国佐治亚州富尔顿县现有的梅赛德斯-奔驰工厂转移多达 500 个工作岗位，并投资数百万美元在亚特兰大都会区为来自美国各地的技术团队建立一座最先进的未来研发设施。

(六) 通信电子

- **中兴通讯与广西大数据发展局签署战略合作协议**

6月21日，中兴通讯与广西大数据发展局签署战略合作协议，双方将聚焦数字化转型领域开展深度合作。根据协议内容，合作范围涵盖 5G 技术应用、智慧城市建设和数据安全等关键领域，旨在推动区域数字经济发展。

（七）医疗电子

- **西门子医疗拟收购 Sirtex Medical 加码癌症靶向治疗领域**

5月29日，西门子医疗宣布，计划收购专注开发和商业化癌症治疗靶向微球产品的美国医疗技术公司 Sirtex Medical。Sirtex Medical 在癌症治疗领域成果突出，其 SIR - Spheres Y - 90 树脂微球靶向放射疗法，已在超 50 个国家为超 15 万例患者提供治疗。此次收购若达成，将扩充西门子医疗的肿瘤治疗产品线，增强其在癌症治疗市场的竞争力。

四、重点产品行情

（一）存储芯片

● NAND 闪存产能收缩超 30%，DDR4 内存因停产通知引发囤货潮

1) 市场竞争

- 当前全球存储芯片市场仍由三星、SK 海力士、美光等国际巨头主导，由于产能供应吃紧，三大厂商决定将更多的资源倾斜到盈利能力更高的 DDR5 和 HBM 产品上，逐步退出毛利率低的 DDR4 市场。
- 随着原厂减产和市场格局调整，国产存储厂商在技术创新、产能提升和市场份额拓展上面临更大压力的同时，也有更多机会去填补市场空白，提升自身竞争力。

2) 供需关系

- 供应端：自 2025 年一季度以来，三星、SK 海力士、美光等各大存储厂商均发布减产计划。6 月，三星正式宣布停止 MLC NAND 生产；原厂累计收缩 NAND 产能超 30%，并先后放出 DDR4 停产时程，目前 DDR4 现货价格已超过同规格 DDR5。
- 需求端：AI 服务器对高带宽内存（HBM）需求激增，推动 DRAM 产品结构向高端迁移；智能汽车自动驾驶系统存储需求较传统车型呈指数级增长；边缘计算设备催生对中小容量、高可靠性存储芯片的需求增长。

3) 价格方面

- DRAM：6 月 DDR4 现货价格暴涨 50%，美光 8GB DDR4 报价达 2.7 美元，三星 8GB DDR4 现货价 4.8 美元，16GB DDR4 突破 6 美元。
- NAND：5 月 128GB NAND 均价 2.92 美元（环比+4.84%），企业级 SSD 用 3D NAND 晶圆价格涨 10%-15%，预计 Q2 整体涨幅 5%-15%。
- eMMC：16GB/32GB/64GB eMMC 价格已趋同（约 3.8 美元），因 MLC NAND 停产，TV/安防等终端被迫升级容量。

各厂商存储芯片 5 月交期情况

厂商	产品系列	交期（周）	交期趋势
SK 海力士	NAND FLASH	6-10	交期稳定
SK Hynix	eMMC	8-12	交期稳定
英飞凌	SRAM	12-52	交期稳定
INFINEON	NOR FLASH	12-26	交期稳定
兆易创新	NOR FLASH	8-12	交期稳定
GigaDevice	NAND FLASH	6-10	交期稳定

信息来源：网络公开资料整理

(二) GPU

● 英伟达占据 AIB 市场 92%份额，英特尔市场份额则跌至 0%

1) 市场行情

- 据市场调查机构 Jon Peddie Research（JPR）的 6 月最新报告数据显示，2025 年第一季度全球基于 PC 的图形附加卡（AIB）市场规模达到了 920 万块。英伟达的市场份额飙升至 92%，展现了其在高端 GPU 市场的统治地位。与此同时，AMD 的市场份额降至 8%，英特尔的市场份额则跌至 0%。
- 国产替代进程明显加速，寒武纪、海光信息等企业通过架构创新实现技术突破，其 7nm 制程 GPU 产品在 AI 推理场景的能效比已接近国际主流水平，2025 年国产 GPU 市场渗透率有望突破 15%。

2) 供需关系

- 供应端：英伟达、AMD 和英特尔仍是全球 GPU 市场的主要供应方。英伟达在 2025 年推出了多款 RTX 50 系列显卡，AMD 则推出了 RDNA4 系列显卡，英特尔早在 2024 年第四季度就推出了 Battle mage B 系列 GPU。此外，国产 GPU 厂商如摩尔线程、华为等也在不断加大研发和生产投入，提升供应能力。
- 需求端：从全球来看，2025 年第一季度整体 PC GPU 市场（包括集成显卡）较上一季度下降了 12%，达到 6880 万块。其中，桌面显卡出货量下降了 16%，笔记本显卡的出货量也下降了 10%。但在数据中心、人工智能等领域，GPU 的需求依然旺盛。随着 AI 技术的不断发展以及应用场景的拓展，如智能驾驶、云计算、工业仿真等，对 GPU 的算力需求持续攀升。

3) 价格方面

- 显卡：英伟达 RTX 5090 被禁售后推出国行版 RTX 5090D，首发价预计从 16499 元起。AMD 的 RX 9070 系列价格上涨，如 Power Color 的 RX 9070 XT Reaper 价格从 599 美元涨至 699 美元，XFX RX 9070 XT Swift 价格飙升至 730 美元。
- 数据中心：英伟达 H100 售价 220 万元，H200 溢价 4.5%至 230 万元，A100 因库存消化降 15 万元。AMD MI300X 价格较 H100 低 20%。

各厂商 GPU 5 月市场趋势

厂商	订单趋势	价格趋势
英伟达 NVIDIA	上升	上升
超威半导体 AMD	稳定	稳定
英特尔 Intel	稳定	稳定
高通 Qualcomm	稳定	稳定

信息来源：网络公开资料整理

(三) MCU

● MCU 车规市场规模可观，国产替代化加速

1) 市场行情

- 随着智能电动车快速发展，32 位 MCU 的用量正逐步提高，目前 32 位 MCU 在汽车领域占比已接近 80%。从产品趋势上看，32 位 MCU 被认为是未来几年增量可观的市场，产品占比还将继续提升，加速替代过去中低端的 8/16 位产品。此外，RISC-V 架构在车规领域的应用也取得了突破，为 MCU 市场带来了新的发展机遇。

2) 供需关系

- 供应端：据 2025 年全球车规级 MCU 行业技术发展与市场前景分析报告显示：全球晶圆代工产能向车规级倾斜，12 英寸晶圆生产线占比提升至 70%。在设计环节，国际巨头通过模块化 IP 核降低开发成本，而本土企业倾向于与整车厂联合定义芯片规格。此外，随着制程工艺的不断进步，40nm 及以下制程工艺占比超过 60%，

部分高端车型开始采用 16nm FinFET 工艺的域控制器级 MCU。

- 需求端：2025 年全球车规级 MCU 市场规模预计达到 120 亿美元，年复合增长率维持在 14%以上，并且随着新能源汽车的渗透率突破 40%，以及智能驾驶技术从 L2 向 L3/L4 快速迭代，车规 MCU 的需求呈现爆发式增长。在应用领域方面，传统动力总成 MCU 的份额有所下降，而智能座舱、自动驾驶相关 MCU 的需求占比超过 45%。

3) 价格方面

- 整体趋势：2025 年 5 月 MCU 整体市场价格相对稳定，但受制程工艺升级、产品结构调整等因素影响，高端车规 MCU 产品价格呈现稳中有升的趋势，而中低端产品价格则相对平稳。
- 具体产品：低配的 8 位 MCU 价格已突破 0.15 美金，主流的 8 位 MCU 价位基本在 0.15-0.6 美金。主流的 32 位 MCU 市场平均价格在 2 美金左右，基于 ARM Cortex-M0 的 32 位 MCU 产品平均价格在 1 美金以下，低配的基于 ARM Cortex-M0 32 位 MCU 已经降到了 0.3 美金。

各厂商 MCU 5 月交期情况

厂商	产品系列	交期（周）	交期趋势
意法半导体 ST	8 位 MCU	10-24	交期稳定
	32 位 MCU	13-16	交期缩短
	汽车 MCU	40-52	交期稳定
英飞凌 INFINEON	8 位 MCU	10-26	交期稳定
	32 位 MCU	10-26	交期稳定
	汽车 MCU	32-54	交期稳定
恩智浦 NXP	8 位 MCU	13-39	交期稳定
	32 位 MCU	18-39	交期稳定
	汽车 MCU	18-52	交期稳定
微芯 MICROCHIP	8 位 MCU	4-12	交期稳定
	32 位 MCU	4-18	交期稳定

信息来源：网络公开资料整理

信息来源

- [1] World Economic Forum. "Markets cautious in wake of US-China trade framework, and other finance news to know.", 2025.
- [2] Discovery Alert. "US-China Trade Talks in London: New Battlegrounds Emerge.", 2025.
- [3] World Economic Forum. "US-China trade framework agreed and other international trade stories to know this month.", 2025.
- [4] RAND. "As U.S.-China Trade Talks Continue, Europe Needs a Plan to Navigate Uncertainty.", 2025.
- [5] Time Magazine. "A Timeline of the U.S.-China Trade War During Trump's Second Term.", 2025.
- [6] European Parliament. "Boosting European chip manufacturing for AI – how will the Commission ensure equal development across the EU? | E-002385/2025.", 2025.
- [7] European Commission. "European Chips Act – Update on the latest milestones.", 2025.
- [8] Science|Business. "EU remains committed to global collaboration on microchips.", 2025.
- [9] Japan Forward. "Japan's Economic Security Moment: Turning Resilience into Strategic Advantage.", 2025.
- [10] The Japan Times. "TSMC flags delays in Japan expansion while U.S. plans advance.", 2025.
- [11] Tech in Asia. "SK president urges energy security, global AI ecosystem at G7.", 2025.
- [12] Chosun Ilbo. "SK hynix narrows gap with Samsung as foreign investors drive AI-fueled rally.", 2025.
- [13] Korea JoongAng Daily. "Global demand for chips boosts Korean presence in market as competition rises.", 2025.
- [14] CBBC Focus. "China's Semiconductor Sector.", 2025.
- [15] Asia Times. "Huawei chief hasn't a chip worry in the world.", 2025.
- [16] ECFR. "Chips on the menu: How the EU can get its act together on

semiconductors.", 2025.

[17] Nippon.com. "Japan's Economic Security and Strategic Technology Policy: An Interview with METI's Nishikawa Kazumi.", 2025.

[18] The Quantum Insider. "Building Quantum Literacy: South Korea's Strategic Integration of Science, Society, and Sovereignty.", 2025.

[19] Capacity Media. "OpenAI to open first international Stargate data centre in UAE.", 2025.

[20] The Economic Times. "GlobalFoundries boosts investment plans to \$16 billion, with research focus.", 2025.

[21] Fintechnews Middle East. "OpenAI to Build Major AI Data Centre in Abu Dhabi.", 2025.

[22] Manufacturing Dive. "GlobalFoundries commits \$16B to expand New York, Vermont facilities.", 2025.

[23] Tech in Asia. "Huawei lags behind US chips but finds workarounds, CEO says.", 2025.

[24] World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). (2025, June 3). WSTS Semiconductor Market Forecast Spring 2025.

[25] 美光宣布逐步停止 DDR4 出货, 存储芯片报价跳涨 50%, 电子工程世界, 2025

[26] 长鑫存储 19nm DDR4 良率达 85%加速国产替代, 半导体行业观察, 2025

[27] 英飞凌通过马来西亚工厂将车规 MCU 产能提升 20%, 在短期内缓解电动车芯片供应压力, 英飞凌官方新闻稿, 2025

[28] 英伟达与台积电合作在 6 月启动 2nm GB300 AI 超算中心建设, 英伟达官方新闻稿, 2025

[29] 三星计划于 2028 年商用玻璃基板封装技术, 三星官方新闻稿, 2025

[30] 德州仪器与亚德诺联合推出 10W TDP 功耗、100TOPS 算力的边缘 AI 协处理器, 德州仪器官方新闻稿, 2025

[31] 恩智浦完成对 TTTech Auto 的战略收购, 恩智浦官方新闻稿, 2025

[32] 台积电宣布暂停向中国大陆 AI/GPU 客户供应所有 7nm 及更先进工艺的芯片, 台积电官方声明, 2025

[33] 博通发布全球首款单芯片带宽 102.4Tbps 的 Tomahawk 6 交换机, 博通官方新闻稿, 2025

- [34] 瑞萨解散 SiC 团队并出售高崎工厂设备，瑞萨官方声明，2025
- [35] 中芯国际 2025 年第一季度营收达 22.47 亿美元，同比增长 1.8%，中芯国际官方财报，2025
- [36] 英伟达开启“攻城略地”模式，拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂-新浪网
- [37] 百度官宣启动最大规模顶尖 AI 人才招聘，岗位扩增超 60%-36 氪
- [38] “至暗时刻”逆势扩产！千亿巨头，出手-世纪新能源网
- [39] 国产工控巨头埃斯顿入局人形机器人：埃斯顿酷卓 CODROID 01 亮相，核心部件全自研
- [40] 荣耀 400 海外预售远超预期两三倍 李健：正加速供货_ZAKER 新闻
- [41] RTX3060 霸榜五年！2025 显卡市场大洗牌，2025
- [42] 存储芯片价格狂飙！这三类 A 股龙头迎来黄金爆发期
- [43] 台湾《电子时报》：NVIDIA 将 GPU 价格上调 25%
- [44] 2025 一季度 AIB GPU 市场：英伟达份额达 92%，AMD 与英特尔受挫
- [45] 2025-2030 中国 GPU 市场发展现状调查及供需格局分析研究报告
- [46] 英伟达 AI 芯片出口规则调整之下：国产算力产业链合力突围
- [47] 2025 年显卡天梯图出炉了，价格走势如何？
- [48] 2025 年全球车规级 MCU 行业技术发展与市场前景分析报告
- [49] 量价齐升的黄金赛道，本土车规级高端 MCU 崭露头角

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2025 年 6 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有8个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。



洞察行情 精准决策

